

「斜め切削装置」の紹介

○ 本設備は、表面から極浅い角度で斜めに試料を切削する装置です。

多層構造の試料断面をあえて斜めに切削することで薄い多層膜を拡大表示させることができます。(左下図) →表面分析の前処理に利用可能
 切削時は印加される力も検出できるため、界面から被着体をはがす強度を調べることもできます。 →膜の剥離強度、せん断強度の評価

メーカー・型式

- ・メーカー：ダイプラ・ウインタス株式会社
- ・型式：SAICAS EN-W

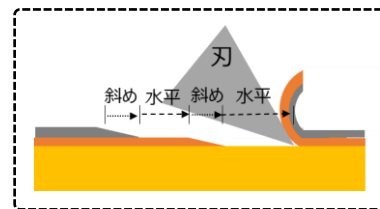
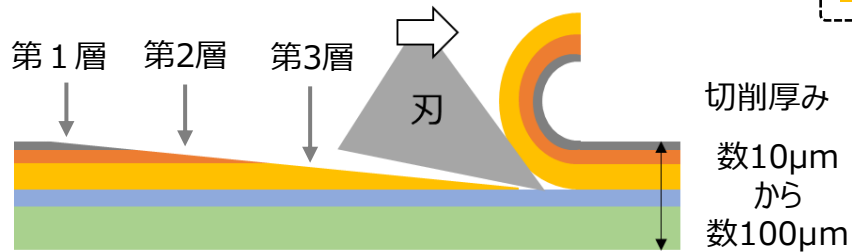
<主な仕様と測定方法>

- ・切り刃幅 0.3、1.0、4.0 mm
- ・切り込み角度 約0.02° ~
- ・水平方向の繰り返し切削可能
- ・剥離強度、せん断強度の測定可能



斜め切削装置(SAICAS)外観

- 浅い角度で精密に切削、多層膜各層をむき出し
 - ✓ せん断強度、剥離強度を測定可能
 - ✓ 各層の表面分析(FTIR、XPS、オージェなど)が可能となる



【基板上的多層電極測定例】

